



2024-2028年 中国未来产业之半导体行业产业链趋势 预测及投资机会研究报告（上下卷）

中投产业研究院出品

中投产业研究院出品

中投产业研究院出品

内容简介

半导体是指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体在收音机、电视机以及测温上有着广泛的应用。如二极管就是采用半导体制作的器件。半导体是指一种导电性可受控制，范围可从绝缘体至导体之间的材料。无论从科技或是经济发展的角度来看，半导体的重要性都是非常巨大的。

2022年全球半导体行业销售总额为5,741亿美元，是有史以来最高的年度总额，与2021年的5,559亿美元相比，增长了3.3%；**2023年11月全球半导体行业销售总额为480亿美元，比2022年11月的456亿美元增长5.3%，比2023年10月的466亿美元增长2.9%。**从地区来看，**2023年11月，中国(7.6%)、亚太/其他地区(7.1%)、欧洲(5.6%)和美洲(3.5%)的销售额同比增长，但日本(-2.8%)有所下降。中国(4.4%)、美洲(3.9%)和亚太/其他地区(3.5%)的销量环比增长，但日本(-0.7%)和欧洲(-2.0%)的销量环比下降。**

当前，我国迎来了半导体产业发展的极佳机遇。2023年8月，工业和信息化部发布《新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035年）》，提到全面推进新兴产业标准体系建设，研制集成电路材料、专用设备与零部件等标准，制修订设计工具、接口规范、封装测试等标准，研制新型存储、处理器等高端芯片标准，开展人工智能芯片、车用芯片、消费电子用芯片等应用标准研究。**2024年1月18日，工信部等七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出发展高性能碳纤维、先进半导体等关键战略材料，加快超导材料等前沿新材料创新应用。**

中投产业研究院发布的《2024-2028年中国半导体行业产业链深度调研及投资前景预测报告》共十七章。首先介绍了半导体行业的总体概况及全球行业发展形势，接着分析了中国半导体行业发展环境、半导体市场总体发展状况。然后分别对半导体产业的产业链相关行业、行业重点企业的经营状况及行业项目案例投资进行了详尽的透析。最后，报告对半导体行业进行了投资分析并对行业未来发展前景进行了科学的预测。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、工信部、中国海关总署、中投产业

研究院、中投产业研究院市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对半导体产业链有个系统深入的了解、或者想投资半导体产业链，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

报告目录

“半导体产业”入选中投顾问2024年十大投资热点！

1. **半导体产业属于国民经济的基础性支撑产业**。无论是从科技还是经济的角度看，半导体的重要性都是非常巨大且难以替代的，政府对产业的扶持态度也十分坚定。

2022年中国集成电路产业销售额为12,006.1亿元，同比增长14.8%。我国半导体产业景气度持续走高，迎来新一轮发展机遇。

2. **半导体产业需求强劲**。随着我国经济发展方式的转变、产业结构的加快调整，工业化和信息化的深度融合，加上政府大力推进本地的信息消费，预计未来五年（2024-2028）年均复合增长率约为8.57%，2028年将达到17,467亿元。

3. **半导体细分产业众多，市场分割性强，投资机会大**。半导体产业链条长，应用领域广阔，具有很强的市场分割性，从上游的半导体材料到中游的设备再到下游的应用领域所涉及的范围十分广大，很难形成一家独大的垄断格局，因此有利于企业利用自身特点，形成自己的技术体系和竞争优势。

第一章 半导体行业概述

1.1 半导体的定义和分类

1.1.1 半导体的定义

1.1.2 半导体的分类

1.1.3 半导体的应用

1.2 半导体产业链分析

1.2.1 半导体产业链结构

1.2.2 半导体产业链流程

1.2.3 半导体产业链转移

第二章 2022-2024年全球半导体产业发展分析

2.1 2022-2024年全球半导体市场总体分析

2.1.1 市场销售规模

2.1.2 行业产品结构

2.1.3 区域市场格局

2.1.4 企业营收排名

2.1.5 企业支出状况

2.2 美国半导体市场发展分析

2.2.1 产业发展综述

2.2.2 市场份额分布

2.2.3 研发投入情况

2.2.4 资本支出状况

2.2.5 产业人才状况

2.2.6 未来发展前景

2.3 韩国半导体市场发展分析

2.3.1 产业发展阶段

2.3.2 产业发展现状

2.3.3 市场发展规模

2.3.4 市场贸易规模

2.3.5 产业发展难题

2.3.6 产业发展规划

2.4 日本半导体市场发展分析

2.4.1 行业发展历史

2.4.2 市场发展规模

2.4.3 企业运营情况

2.4.4 市场贸易状况

2.4.5 对外贸易制裁

2.4.6 行业实施方案

2.4.7 行业发展经验

2.5 其他国家

2.5.1 加拿大

2.5.2 英国

2.5.3 法国

2.5.4 德国

第三章 2022-2024年中国半导体产业发展环境分析

3.1 中国宏观经济环境分析

3.1.1 宏观经济概况

3.1.2 对外经济分析

3.1.3 固定资产投资

3.1.4 工业运行情况

3.1.5 宏观经济展望

3.2 社会环境

3.2.1 移动网络运行状况

3.2.2 电子信息产业增速

3.2.3 电子信息制造业特点

3.2.4 中美科技战的影响

3.3 技术环境

3.3.1 研发经费投入增长

3.3.2 摩尔定律发展放缓

3.3.3 产业专利申请状况

第四章 2022-2024年中国半导体产业政策环境分析

4.1 政策体系分析

4.1.1 管理体系

4.1.2 政策汇总

4.1.3 发展规范

4.2 重要政策解读

4.2.1 集成电路设计等企业发展鼓励政策

4.2.2 集成电路产业发展进口税收政策

4.2.3 集成电路企业清单制定要求

4.3 相关政策分析

4.3.1 推进双一流建设的意见

4.3.2 中国制造行业发展目标

4.3.3 “十四五”智能制造发展规划

4.3.4 “十四五”数字经济发展规划

4.4 地区发展规划分析

4.4.1 长三角地区

4.4.2 环渤海经济区

4.4.3 珠三角地区

4.4.4 中西部地区

第五章 2022-2024年中国半导体产业发展分析

5.1 中国半导体产业发展背景

5.1.1 产业发展历程

5.1.2 产业供需现状

5.1.3 大基金投资规模

5.2 2022-2024年中国半导体市场运行状况

5.2.1 产业销售规模

5.2.2 产业区域分布

5.2.3 相关企业数量

5.2.4 行业研发费用

5.2.5 市场需求分析

5.3 半导体行业财务状况分析

- 5.3.1 上市公司规模
- 5.3.2 行业营收规模
- 5.3.3 盈利能力分析
- 5.3.4 现金流量分析
- 5.3.5 运营能力分析
- 5.4 半导体行业工艺流程用膜分析
 - 5.4.1 蓝膜晶圆的介绍及用途
 - 5.4.2 晶圆制程保护膜的应用
 - 5.4.3 半导体封装DAF膜介绍
 - 5.4.4 晶圆芯片保护膜的封装需求
 - 5.4.5 氧化物半导体薄膜制备技术
- 5.5 中国半导体产业发展问题分析
 - 5.5.1 产业发展短板
 - 5.5.2 技术发展壁垒
 - 5.5.3 贸易摩擦影响
 - 5.5.4 市场垄断困境
- 5.6 中国半导体产业发展措施建议
 - 5.6.1 产业发展战略
 - 5.6.2 产业发展路径
 - 5.6.3 研发核心技术
 - 5.6.4 人才发展策略
 - 5.6.5 突破垄断策略

第六章 2022-2024年中国半导体行业上游半导体材料发展综述

- 6.1 半导体材料相关概述
 - 6.1.1 半导体材料基本介绍
 - 6.1.2 半导体材料产业地位
 - 6.1.3 半导体材料演进分析

6.2 2022-2024年全球半导体材料发展状况

6.2.1 市场规模分析

6.2.2 市场营收规模

6.2.3 市场格局分析

6.2.4 市场发展预测

6.3 2022-2024年中国半导体材料行业运行状况

6.3.1 应用环节分析

6.3.2 产业支持政策

6.3.3 市场规模分析

6.3.4 市场运行情况

6.3.5 企业注册数量

6.3.6 企业相关规划

6.3.7 细分市场发展

6.3.8 项目建设动态

6.3.9 国产替代进程

6.4 半导体制造主要材料：硅片

6.4.1 硅片基本简介

6.4.2 硅片生产工艺

6.4.3 硅片材料对比

6.4.4 行业地位分析

6.4.5 市场运行情况

6.4.6 市场产能分析

6.4.7 硅片制造厂家

6.4.8 硅片竞争格局

6.4.9 硅片产业壁垒

6.4.10 硅片产业机遇

6.4.11 硅片尺寸趋势

6.5 半导体制造主要材料：靶材

6.5.1 靶材基本简介

6.5.2 靶材生产工艺

6.5.3 市场发展规模

6.5.4 全球市场格局

6.5.5 国内市场格局

6.5.6 技术发展趋势

6.6 半导体制造主要材料：光刻胶

6.6.1 光刻胶基本简介

6.6.2 光刻胶工艺流程

6.6.3 光刻胶发展现状

6.6.4 光刻胶市场经营

6.6.5 光刻胶市场竞争

6.6.6 光刻胶企业业务

6.6.7 光刻胶投资兼并

6.6.8 光刻胶产业问题

6.6.9 光刻胶提升方面

6.6.10 光刻胶发展前景

6.7 其他主要半导体材料市场发展分析

6.7.1 掩膜版

6.7.2 键合丝

6.7.3 封装材料

6.7.4 CMP材料

6.7.5 湿电子化学品

6.7.6 电子特种气体

6.8 中国半导体材料行业存在的问题及发展对策

6.8.1 行业发展滞后

6.8.2 产品同质化问题

6.8.3 核心技术缺乏

6.8.4 行业发展建议

6.8.5 行业发展思路

6.9 半导体材料产业未来发展前景展望

6.9.1 行业发展趋势

6.9.2 行业需求分析

6.9.3 行业前景分析

第七章 2022-2024年中国半导体行业上游半导体设备发展分析

7.1 半导体设备相关概述

7.1.1 半导体设备重要作用

7.1.2 半导体设备主要种类

7.2 全球半导体设备市场发展形势

7.2.1 市场销售规模

7.2.2 市场结构分析

7.2.3 市场区域分布

7.2.4 市场竞争格局

7.2.5 重点厂商介绍

7.2.6 厂商竞争优势

7.3 2022-2024年中国半导体设备市场发展现状

7.3.1 市场销售规模

7.3.2 市场需求分析

7.3.3 企业竞争态势

7.3.4 市场国产化率

7.3.5 企业招标情况

7.3.6 行业进口情况

7.3.7 企业研发情况

7.4 半导体产业链主要环节核心设备分析

7.4.1 硅片制造设备

7.4.2 晶圆制造设备

7.4.3 封装测试设备

7.5 中国半导体设备市场投资机遇分析

7.5.1 行业投资机会分析

7.5.2 行业投资阶段分析

7.5.3 行业发展前景展望

7.5.4 行业投资策略建议

第八章 2022-2024年中国半导体行业中游集成电路产业分析

8.1 2022-2024年中国集成电路产业发展综况

8.1.1 集成电路产业链

8.1.2 产业发展特征

8.1.3 产业销售规模

8.1.4 产品产量规模

8.1.5 市场贸易状况

8.1.6 人才需求规模

8.2 2022-2024年中国IC设计行业发展分析

8.2.1 行业发展历程

8.2.2 市场发展规模

8.2.3 企业发展状况

8.2.4 企业营收排名

8.2.5 区域分布状况

8.2.6 从业人员规模

8.2.7 行业面临挑战

8.3 2022-2024年中国IC制造行业发展分析

8.3.1 晶圆生产工艺

8.3.2 晶圆加工技术

8.3.3 市场发展规模

8.3.4 代工企业营收

8.3.5 行业发展困境

8.3.6 行业发展措施

8.3.7 行业发展目标

8.4 2022-2024年中国IC封装测试行业发展分析

8.4.1 行业概念界定

8.4.2 行业基本特点

8.4.3 行业发展规律

8.4.4 市场发展规模

8.4.5 典型企业布局

8.4.6 核心竞争要素

8.4.7 行业发展趋势

8.5 中国集成电路产业发展思路解析

8.5.1 产业发展建议

8.5.2 产业突破方向

8.5.3 产业创新发展

8.6 集成电路行业未来发展趋势及潜力分析

8.6.1 全球市场趋势

8.6.2 行业发展机遇

8.6.3 市场发展前景

第九章 2022-2024年其他半导体细分行业发展分析

9.1 传感器行业分析

9.1.1 产业链结构分析

9.1.2 市场发展规模

9.1.3 市场结构分析

9.1.4 区域分布格局

9.1.5 企业数量规模

9.1.6 主要竞争企业

9.1.7 专利申请数量

9.1.8 市场发展态势

9.1.9 行业发展问题

9.1.10 行业发展对策

9.2 分立器件行业分析

9.2.1 市场产业链条

9.2.2 市场销售规模

9.2.3 行业产量规模

9.2.4 行业竞争格局

9.2.5 行业进入壁垒

9.2.6 行业技术水平

9.2.7 行业发展趋势

9.3 光电器件行业分析

9.3.1 行业基本概述

9.3.2 行业产量规模

9.3.3 企业注册数量

9.3.4 专利申请数量

9.3.5 行业投融资规模

9.3.6 行业进入壁垒

9.3.7 行业发展策略

9.3.8 行业发展趋势

第十章 2022-2024年中国半导体行业下游应用领域发展分析

10.1 半导体下游终端需求结构

10.2 消费电子

10.2.1 产业发展规模

10.2.2 行业发展态势

10.2.3 企业竞争情况

10.2.4 投融资情况分析

10.2.5 行业集成电路应用

10.2.6 产业未来发展趋势

10.3 汽车电子

10.3.1 产品及分类

10.3.2 产业环境分析

10.3.3 产业链条分析

10.3.4 市场规模分析

10.3.5 成本比重分析

10.3.6 市场竞争格局

10.3.7 市场应用分析

10.3.8 行业前景展望

10.4 物联网

10.4.1 产业核心地位

10.4.2 产业模式创新

10.4.3 政策支持分析

10.4.4 产业规模状况

10.4.5 行业应用分析

10.4.6 未来发展趋势

10.5 创新应用领域

10.5.1 5G芯片应用

10.5.2 人工智能芯片

10.5.3 量子芯片

第十一章 2022-2024年中国半导体产业区域发展分析

11.1 中国半导体产业区域布局分析

11.2 长三角地区半导体产业发展分析

11.2.1 区域市场发展形势

11.2.2 技术创新发展路径

11.2.3 上海产业发展状况

11.2.4 浙江产业发展情况

11.2.5 江苏产业发展规模

11.2.6 安徽产业发展综况

11.3 京津冀区域半导体产业发展分析

11.3.1 区域产业发展概况

11.3.2 北京产业发展状况

11.3.3 天津推进产业发展

11.3.4 河北产业发展综况

11.4 珠三角地区半导体产业发展分析

11.4.1 广东产业发展状况

11.4.2 深圳产业发展分析

11.4.3 广州产业发展情况

11.4.4 珠海产业发展综况

11.5 中西部地区半导体产业发展分析

11.5.1 四川产业发展综况

11.5.2 成都产业发展综况

11.5.3 湖北产业发展综况

11.5.4 武汉产业发展综况

11.5.5 重庆产业发展综况

11.5.6 陕西产业发展综况

第十二章 2022-2024年国外半导体产业重点企业经营分析

12.1 三星电子 (Samsung Electronics)

12.1.1 企业发展概况

12.1.2 企业经营状况

12.1.3 企业研发动态

12.1.4 企业投资计划

12.2 英特尔 (Intel)

12.2.1 企业发展概况

12.2.2 企业经营状况

12.2.3 企业研发动态

12.2.4 企业业务布局

12.3 美光科技 (Micron Technology)

12.3.1 企业发展概况

12.3.2 企业经营状况

12.3.3 业务运营布局

12.3.4 企业竞争优势

12.3.5 企业项目布局

第十三章 2021-2024年中国半导体产业重点企业经营分析

13.1 深圳市海思半导体有限公司

13.1.1 企业发展概况

13.1.2 企业经营状况

13.1.3 产品出货规模

13.1.4 产品发布动态

13.1.5 业务调整动态

13.1.6 企业发展展望

13.2 深圳市中兴微电子技术有限公司

13.2.1 企业发展概况

13.2.2 研发实力分析

13.2.3 企业发展历程

13.2.4 企业经营状况

13.2.5 企业发展战略

13.3 杭州士兰微电子股份有限公司

13.3.1 企业发展概况

13.3.2 经营效益分析

13.3.3 业务经营分析

13.3.4 财务状况分析

13.3.5 核心竞争力分析

13.3.6 公司发展战略

13.4 台湾积体电路制造公司

13.4.1 企业发展概况

13.4.2 企业经营状况

13.4.3 项目投资布局

13.4.4 资本开支计划

13.5 中芯国际集成电路制造有限公司

13.5.1 企业发展概况

13.5.2 经营效益分析

13.5.3 业务经营分析

13.5.4 财务状况分析

13.5.5 核心竞争力分析

13.5.6 公司发展战略

13.6 华虹半导体有限公司

13.6.1 企业发展概况

13.6.2 业务发展范围

13.6.3 经营效益分析

13.6.4 业务经营分析

13.6.5 财务状况分析

13.6.6 核心竞争力分析

13.6.7 公司发展战略

13.6.8 未来前景展望

13.7 江苏长电科技股份有限公司

13.7.1 企业发展概况

13.7.2 经营效益分析

13.7.3 业务经营分析

13.7.4 财务状况分析

13.7.5 核心竞争力分析

13.7.6 公司发展战略

13.7.7 未来前景展望

13.8 北方华创科技集团股份有限公司

13.8.1 企业发展概况

13.8.2 经营效益分析

13.8.3 业务经营分析

13.8.4 财务状况分析

13.8.5 核心竞争力分析

13.8.6 未来前景展望

第十四章 中国集成电路产业典型项目投资建设深度解析

14.1 新一代Wi-Fi射频前端芯片研发及产业化项目

14.1.1 项目基本概况

14.1.2 项目的必要性

14.1.3 项目的可行性

14.1.4 项目投资概算

14.1.5 项目进度安排

14.2 半导体封装测试扩建项目

14.2.1 项目基本概况

14.2.2 项目的必要性

14.2.3 项目的可行性

14.2.4 项目投资概算

14.2.5 项目进度安排

14.2.6 项目实施地点

14.2.7 项目环保情况

14.2.8 项目经济效益

14.3 第三代半导体及硅功率器件先进封测项目

14.3.1 项目基本概况

14.3.2 项目的必要性

14.3.3 项目的可行性

14.3.4 项目投资概算

14.3.5 项目实施地点

14.3.6 项目进度安排

14.3.7 项目投资效益

14.4 高端电源管理芯片产业化项目

14.4.1 项目基本概况

14.4.2 项目的必要性

14.4.3 项目的可行性

14.4.4 项目投资概算

14.4.5 项目实施进度

14.4.6 项目经济效益

第十五章 中投顾问对半导体产业投资热点及价值综合评估

15.1 半导体产业并购状况分析

15.1.1 国际企业并购事件

15.1.2 全球并购领域分布

15.1.3 国内企业并购事件

- 15.1.4 国内并购趋势预测
- 15.1.5 市场并购机遇及挑战
- 15.1.6 市场并购应对策略
- 15.2 半导体产业投融资状况分析
 - 15.2.1 融资规模数量
 - 15.2.2 平均融资金额
 - 15.2.3 融资轮次分布
 - 15.2.4 细分融资赛道
 - 15.2.5 融资区域分布
 - 15.2.6 活跃投资主体
 - 15.2.7 新晋独角兽企业
 - 15.2.8 产业链投资机会
- 15.3 中投顾问对半导体产业进入壁垒评估
 - 15.3.1 技术壁垒
 - 15.3.2 资金壁垒
 - 15.3.3 人才壁垒
- 15.4 中投顾问对集成电路产业投资价值评估及投资建议
 - 15.4.1 投资价值综合评估
 - 15.4.2 市场机会矩阵分析
 - 15.4.3 产业进入时机分析
 - 15.4.4 产业投资风险剖析
 - 15.4.5 产业投资策略建议
- 第十六章 中国半导体行业上市公司资本布局分析
 - 16.1 中投顾问对中国半导体行业投资指数分析
 - 16.1.1 投资项目数量
 - 16.1.2 投资金额分析
 - 16.1.3 项目均价分析

16.2 中投顾问对中国半导体行业资本流向统计分析

16.2.1 投资流向统计

16.2.2 投资来源统计

16.2.3 投资进出平衡状况

16.3 A股及新三板上市公司在半导体行业投资动态分析

16.3.1 投资项目综述

16.3.2 投资区域分布

16.3.3 投资模式分析

16.3.4 典型投资案例

16.4 中投顾问对中国半导体行业上市公司投资排行及分布状况

16.4.1 企业投资排名

16.4.2 企业投资分布

16.5 中投顾问对中国半导体行业重点投资标的推介

16.5.1 苏州锓威特半导体股份有限公司

16.5.2 江苏微导纳米科技股份有限公司

16.5.3 烟台睿创微纳技术股份有限公司

16.5.4 科威尔技术股份有限公司

16.5.5 江苏宏微科技股份有限公司

第十七章 中投顾问对2024-2028年中国半导体产业发展前景及趋势预测分析

17.1 中国半导体产业整体发展前景展望

17.1.1 技术发展利好

17.1.2 行业发展机遇

17.1.3 进口替代良机

17.1.4 发展趋势向好

17.1.5 行业发展预测

17.2 “十四五”中国半导体产业链发展前景

17.2.1 产业上游发展前景

17.2.2 产业中游发展前景

17.2.3 产业下游发展前景

17.3 中投顾问对2024-2028年中国半导体产业预测分析

17.3.1 2024-2028年中国半导体产业影响因素分析

17.3.2 2024-2028年中国集成电路行业销售额预测

17.3.3 2024-2028年中国IC封装测试业销售额预测

17.3.4 2024-2028年中国IC制造业销售额预测

图表目录

图表 半导体分类结构图

图表 半导体分类

图表 半导体分类及应用

图表 半导体产业链示意图

图表 半导体上下游产业链

图表 半导体产业转移和产业分工

图表 集成电路产业转移状况

图表 全球主要半导体厂商

图表 2022年全球半导体细分品类销售额占比

图表 2011-2022年全球半导体各细分品类市场规模变化

图表 2023年全球半导体销售额区域分布结构

图表 2022年全球排名前十半导体厂商收入

图表 2021-2023年全球半导体资本开支结构及预测

图表 2021年美国半导体公司在全球主要地区的市场占有率

图表 2001-2021年美国半导体产业研发支出和设备支出在销售额中占比

图表 美国半导体产业研发投入率在美国本土科技产业中排名

图表 美国半导体行业资本支出占销售收入的比重变化

图表 日本半导体产业发展历程

图表 2017-2022年日本半导体设备出货额

图表 2021年日本半导体企业销售额排行榜

图表 半导体企业经营模式发展历程

图表 IDM商业模式

图表 Fabless+Foundry模式

图表 2018-2022年研究与试验发展（R&D）经费支出及其增长速度

图表 国家层面集成电路行业政策及重点内容解读（一）

图表 国家层面集成电路行业政策及重点内容解读（二）

图表 国家层面集成电路行业政策及重点内容解读（三）

图表 “十四五”以来集成电路行业重点规划解读

图表 《中国制造2025》关于集成电路行业发展目标

图表 国内半导体发展阶段

图表 国家集成电路产业发展推进纲要

图表 2016-2023年中国半导体月度销售额及增速情况

图表 2016-2023年中国半导体行业相关企业注册量

图表 2022年半导体行业研发费用居前的10大企业

图表 2022年半导体行业研发费用占比居前的10大企业

图表 2018-2022年半导体行业营业收入居前5的企业

图表 2022年半导体企业归母净利润增速区间

图表 2022年半导体行业归母净利润增速居前的10大企业

图表 2022年半导体行业存货周转率表现较差的10大企业

图表 2018-2022年半导体行业毛利率中位数

图表 2022年半导体行业毛利率居前的10大企业

图表 DAF膜产品分类

图表 2017-2022年美国对中国大陆半导体行业限制政策部分梳理

图表 半导体材料产业链

图表 半导体制造过程中所需的材料

图表 国内外半导体原材料产业链

图表 半导体材料演进

图表 2016-2022年全球半导体材料市场规模统计

图表 2021-2022年半导体材料消费市场规模

图表 2022年全球半导体材料产品结构

图表 2021年全球半导体材料主要国家地区结构占比情况

图表 半导体材料主要应用于晶圆制造与封测环节

图表 2016-2023年中国半导体硅片行业发展相关国家政策规划汇总

图表 2016-2023年半导体硅片行业发展相关国家政策规划汇总（续）

图表 部分地区半导体材料相关布局

图表 2018-2022年中国半导体材料市场规模

图表 2015-2023年中国半导体材料相关企业注册数量

图表 2020-2021年部分A股半导体材料公司在细分领域的进展及后续规划（一）

图表 2020-2021年部分A股半导体材料公司在细分领域的进展及后续规划（二）

图表 中国半导体材料细分板块占比

图表 2022年材料项目月度情况

图表 2022年半导体材料项目投资与竣工概况

图表 材料项目地区分布

图表 2022年中国半导体材料国产化率情况

图表 衬底材料分类

图表 硅片尺寸发展历史

图表 硅片按加工工序分类

图表 硅片加工工艺示意图

图表 多晶硅片加工工艺示意图

图表 单晶硅片之制备方法示意图

图表 硅片生产中四大核心技术是影响硅片质量的关键

图表 常见硅片分类方式

图表 大尺寸硅片优势

图表 半导体硅片所处产业链位置

图表 2010-2022年全球硅片产量

图表 2010-2022年中国硅片产量

图表 2023年中国多晶硅进口前三国家及省份情况

图表 2022-2023年中国直径>15.24cm的单晶硅切片出口情况

图表 2023年中国硅片出口前三国家及省份情况

图表 2023年直径>15.24cm的单晶硅切片出口国别/地区分布

图表 2020-2024年全球新增晶圆厂数量分布

图表 2021、2022年全球新建晶圆厂数量分布

图表 国内半导体硅片产能统计（8英寸和12英寸）

图表 国内头部12寸硅片制造厂家

图表 全球12英寸半导体硅片竞争格局

图表 半导体硅片技术参数

图表 溅射靶材工作原理示意图

图表 溅射靶材产品分类

图表 各种溅射靶材性能要求

图表 高纯溅射靶材产业链

图表 铝靶生产工艺流程

图表 靶材制备工艺

图表 高纯溅射靶材生产核心技术

图表 2017-2023年全球溅射靶材市场规模预测趋势图

图表 全球半导体靶材CR4

图表 全球半导体靶材龙头企业

图表 中国靶材市场份额占比情况

图表 国内靶材主要厂商及项目进展

图表 光刻胶基本成分

图表 光刻胶分类总结

图表 集成电路光刻和刻蚀工艺流程（以多晶硅刻蚀及离子注入为例）

图表 2022年中国半导体光刻胶行业国产化情况

图表 中国本土光刻胶上市企业基本情况

图表 2017-2022年中国光刻胶行业上市企业净利润情况

图表 2017-2022年中国光刻胶行业上市企业毛利率情况

图表 2017-2022年中国光刻胶行业上市企业存货周转率情况

图表 2017-2022年中国光刻胶行业上市企业应收账款周转率情况

图表 2017-2022年中国光刻胶行业上市企业资产负债率情况

图表 2017-2022年中国光刻胶行业上市企业流动比率情况

图表 中国光刻胶产业链厂商区域分布热力图

图表 中国光刻胶行业市场竞争格局

图表 2021年中国光刻胶生产结构（按应用领域）

图表 中国光刻胶行业五力竞争综合分析

图表 2022年中国光刻胶上市公司光刻胶业务布局情况分析

图表 2014-2023年中国光刻胶行业融资整体情况

图表 2014-2023年中国光刻胶行业投融资单笔融资情况

图表 截至2023年中国光刻胶行业投融资轮次情况

图表 截至2023年中国光刻胶行业投融资区域分布

图表 2014-2023年中国光刻胶行业投融资事件汇总（一）

图表 2014-2023年中国光刻胶行业投融资事件汇总（二）

图表 2014-2023年中国光刻胶行业投融资事件汇总（三）

图表 2014-2023年中国光刻胶行业融资主体分布

图表 2014-2023年中国光刻胶行业投资主体分布

图表 截至2023年光刻胶行业兼并重组案例分析

图表 光刻胶行业投融资及兼并重组总结

图表 光刻胶行业市场发展趋势

图表 2023-2028年中国光刻胶行业市场规模预测情况

图表 2018-2023年全球半导体掩膜版市场规模

图表 掩膜版重点企业分析

图表 键合丝重点企业

图表 封装所用的主要工艺及其材料

图表 封装中用到的主要材料及作用

图表 2018-2023年中国封装基板市场规模预测趋势图

图表 全球CMP抛光液市场代表企业区域分布

图表 CMP抛光材料产业链条

图表 2015-2021年中国CMP抛光材料市场规模及增速

图表 半导体材料/晶圆材料/抛光材料结构

图表 中国CMP抛光液行业国产替代驱动因素

图表 安集科技在CMP抛光液国产替代的布局

图表 2020-2023年中国湿电子化学品市场需求量预测趋势图

图表 2018-2023年中国电子特种气体市场规模预测趋势图

图表 半导体产业架构图

图表 IC芯片制造核心工艺主要设备全景图

图表 2017-2022年全球半导体设备市场规模及增速

图表 2022年全球半导体设备市场产品结构

图表 2022年全球半导体设备销售情况

图表 2023年全球半导体设备厂商市场规模排名Top10

图表 2016-2022年中国半导体设备市场规模

图表 2016-2022年中国半导体设备销售额占全球比重

图表 2007-2022年晶圆制造每万片/月产能的投资量级呈现加速增长

图表 晶圆制造各环节设备投资占比

图表 2022年中国大陆上市公司半导体设备业务营收排名

图表 2023年中国半导体设备行业上市企业营收情况

图表 2023年半导体国产设备中标台数

图表 2023年半导体国产设备中标国产率

图表 2023年中国半导体设备公司中标情况

图表 2018-2022年半导体设备进出口额

图表 2022年半导体设备进口主要国家或地区

图表 2022年半导体设备出口主要国家或地区

图表 2022年半导体设备进出口国内收发货注册地

图表 2022年半导体设备细分品类进出口状况

图表 2019-2021年半导体设备企业研发投入情况

图表 截至2021年半导体设备企业拥有专利情况

图表 半导体硅片制造工艺

图表 硅片制造相关设备主要生产商

图表 晶圆制造流程

图表 光刻工艺流程

图表 国内刻蚀设备生产商

图表 半导体测试在产业中的应用

图表 不同种类分选机比较

图表 国内主要半导体设备企业

图表 2023年国产半导体设备公司部分融资状况

图表 2023年国产半导体设备公司IPO进程一览

图表 集成电路产业链及部分企业

图表 芯片种类多

图表 2011-2021年全球IC晶圆厂技术演进路线

图表 2017-2022年中国集成电路产业销售额

图表 2021-2023年中国集成电路产量趋势图

图表 2021年全国集成电路产量数据

图表 2021年主要省份集成电路产量占全国产量比重情况

图表 2022年全国集成电路产量数据

图表 2022年主要省份集成电路产量占全国产量比重情况

图表 2023年全国集成电路产量数据

图表 2022年集成电路产量集中程度示意图

图表 2021-2023年中国集成电路进出口总额

图表 2021-2023年中国集成电路进出口结构

图表 2021-2023年中国集成电路贸易逆差规模

图表 2021-2022年中国集成电路进口区域分布

图表 2021-2022年中国集成电路进口市场集中度（分国家）

图表 2022年主要贸易国集成电路进口市场情况

图表 2023年主要贸易国集成电路进口市场情况

图表 2021-2022年中国集成电路出口区域分布

图表 2021-2022年中国集成电路出口市场集中度（分国家）

图表 2022年主要贸易国集成电路出口市场情况

图表 2023年主要贸易国集成电路出口市场情况

图表 2021-2022年主要省市集成电路进口市场集中度（分省市）

图表 2022年主要省市集成电路进口情况

图表 2023年主要省市集成电路进口情况

图表 2021-2022年中国集成电路出口市场集中度（分省市）

图表 2022年主要省市集成电路出口情况

图表 2023年主要省市集成电路出口情况

图表 IC设计的不同阶段

图表 2017-2022年中国IC设计行业销售额

图表 2010-2022年中国IC设计企业数量及增速

图表 2010-2021年中国芯片设计销售额过亿元企业的增长情况

图表 2023年第二季度全球前十大IC设计公司排名

图表 2021年中国集成电路设计行业各区域销售占比情况

图表 2021年中国集成电路设计行业销售规模TOP10城市统计

图表 2018-2022年中国集成电路设计业从业人员规模

图表 晶圆加工过程示意图

图表 2017-2022年中国IC制造业销售额

图表 2021年全球专属晶圆代工排名

图表 2022年全球专属晶圆代工排名

图表 现代电子封装包含的四个层次

图表 根据封装材料分类

图表 目前主流市场的两种封装形式

图表 2011-2022年中国IC封装测试业销售额及增长率

图表 2022年全球封测前十名排名

图表 封装测试技术创新型和技术应用型企业特征

图表 国内集成电路封装测试行业竞争特征

图表 传感器产业链结构分析

图表 2016-2022年中国传感器市场规模及增长率

图表 2015-2023年中国传感器行业相关企业注册量统计情况

图表 2021年中国传感器行业企业基本信息

图表 中国传感器行业竞争梯队（按注册资本）

图表 中国传感器企业区域分布热力图

图表 2017-2021年中国传感器专利申请数量

图表 半导体分立器件行业产业链示意图

图表 2018-2023年中国半导体分立器件市场规模及增速

图表 2016-2023年中国半导体分立器件产量统计

图表 我国半导体分立器件市场主要企业竞争状况

图表 光电子器件分类

图表 2016-2022年中国光电子器件产量变化

图表 2018-2023年中国光电子器件相关企业注册量情况

图表 2014-2023年中国光电子器件相关专利申请情况

图表 2014-2023年中国光电元器件投融资情况

图表 2021-2022年全球智能手机出货量及市场份额

图表 2022年中国智能手表累计产量变化

图表 2022年中国消费电子行业重要参与者

图表 2022年全球消费电子行业重要参与者

图表 2017-2022年中国消费电子行业投融资情况

图表 2021年中国消费电子行业各月投融资情况

图表 2022年中国消费电子行业投融资伦次分布

图表 消费电子中的主要芯片及封装方式

图表 消费电子领域对封装行业需求的影响路径总结

图表 汽车电子产品及分类

图表 中国汽车电子行业部分相关政策一览表

图表 2023年居民人均消费支出及构成

图表 2016-2023年中国汽车累计保有量及增速情况变化

图表 2017-2021年中国汽车电子相关专利申请数量及增速

图表 汽车电子供应链情况

图表 2017-2022年中国汽车电子市场规模

图表 1980-2030年中国汽车电子占整车制造成本比重情况

图表 中国汽车电子行业细分产品占比情况

图表 中国汽车电子行业市场格局情况

图表 汽车电子领域中的主要芯片及封装方式

图表 中国汽车电子对集成电路封装产品需求主要影响因素

图表 半导体是物联网的核心

图表 物联网领域涉及的半导体技术

图表 中国物联网政策的演变过程

图表 物联网行业相关政策汇总（一）

图表 物联网行业相关政策汇总（二）

图表 物联网行业相关政策汇总（三）

图表 《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》简析

图表 各省市物联网行业发展目标热力图

图表 2020-2022年中国物联网行业市场规模情况

图表 2016-2021年中国物联网行业相关企业注册量情况

图表 2016-2023年中国物联网行业投融资情况

图表 物联网芯片主要类别

图表 2022年全球蜂窝物联网芯片组出货量份额

图表 2022年通信模组芯片市场格局

图表 2019-2021年全球5G芯片市场规模

图表 人工智能芯片发展路径

图表 全球主要人工智能芯片企业竞争格局

图表 2016-2023年中国AI芯片领域投融资情况

图表 量子芯片技术体系对比

图表 2012-2022年上海市芯片产量变化趋势

图表 2022-2023年上海市芯片产量变化趋势

图表 上海市集成电路产业主要企业空间布局情况（按注册地）

图表 上海市集成电路产业链相关企业布局情况

图表 上海市芯片产业链图谱

图表 2022年浙江省重点半导体建设项目

图表 2022年浙江省重点半导体建设项目（续）

图表 杭州市芯片产业链图谱

图表 杭州市芯片产业链企业地图

图表 杭州市芯片产业发展载体图谱

图表 宁波市芯片产业链图谱

图表 宁波市芯片产业链企业地图

图表 宁波市芯片产业发展载体图谱

图表 2016-2021年江苏省集成电路产业同期增长情况

图表 合肥市芯片产业链图谱

图表 合肥市芯片产业链企业地图

图表 合肥市芯片产业发展载体图谱

图表 2020-2022年合肥芯片产业产值

图表 2016-2022年合肥芯片行业投融资情况

图表 2012-2022年北京市芯片产量变动情况

图表 2022-2023年北京市芯片月度产量趋势

图表 北京市集成电路产业主要聚集区及各区布局领域（含规划）

图表 北京市芯片产业链企业地图

图表 北京市芯片相关产业发展载体图谱

图表 北京市芯片产业链图谱

图表 天津市芯片产业链图谱

图表 天津市芯片产业链企业地图

图表 天津市芯片产业发展载体图谱

图表 2020-2022年天津市芯片产业链产值

图表 2022-2023年天津市芯片产量

图表 2014-2022年天津市芯片产业历年相关新注册企业数量

图表 2023年河北省规模以上工业企业集成电路产量

图表 2013-2022年深圳市芯片产量变化趋势

图表 深圳市集成电路产业主要企业空间布局情况（按注册地）

图表 深圳市芯片产业链图谱

图表 深圳市芯片产业链企业地图

图表 深圳市芯片产业发展载体图谱

图表 深圳市集成电路产业主要聚集区及布局领域（含规划）

图表 广州市芯片产业链图谱

图表 广州市芯片产业链企业地图

图表 广州市芯片产业发展载体图谱

图表 2019-2021年广州市芯片产值变化趋势

图表 珠海市芯片产业链图谱

图表 珠海市芯片产业链企业地图

图表 珠海市芯片产业发展载体图谱

图表 2018-2021年珠海市芯片产业收入及同比变化情况

图表 2021年珠海市芯片产业收入结构

图表 2017-2021年珠海市芯片产量变化趋势

图表 2010-2022年珠海市芯片产业历年相关新注册企业数量

图表 2023年四川省规模以上工业企业集成电路产量

图表 2017-2022年成都市芯片产量变化趋势

图表 成都市芯片产业链图谱

图表 成都市芯片产业链企业地图

图表 成都市芯片产业发展载体图谱

图表 2014-2022年成都市芯片产业历年相关新注册企业数量

图表 2023年湖北省规模以上工业企业集成电路产量

图表 武汉市集成电路产业主要聚集区布局情况

图表 2019-2021年武汉市集成电路产业相关企业数量及占全国比重

图表 武汉市集成电路产业主要企业空间布局情况（按注册地）

图表 武汉市集成电路产业发展战略目标

图表 2020-2021年三星电子综合收益表

图表 2020-2021年三星电子分部资料

图表 2020-2021年三星电子分地区资料

图表 2021-2022年三星电子综合收益表

图表 2021-2022年三星电子分部资料

图表 2021-2022年三星电子分地区资料

图表 2022-2023年三星电子综合收益表

图表 2020-2021财年英特尔综合收益表

图表 2020-2021财年英特尔分部资料

图表 2020-2021财年英特尔收入分地区资料

图表 2021-2022财年英特尔综合收益表

图表 2021-2022财年英特尔分部资料

图表 2021-2022财年英特尔收入分地区资料

图表 2022-2023财年英特尔综合收益表

图表 2022-2023财年英特尔分部资料

图表 2020-2021财年美光科技综合收益表

图表 2020-2021财年美光科技分部资料

图表 2020-2021财年美光科技收入分地区资料

图表 2021-2022财年美光科技综合收益表

图表 2021-2022财年美光科技分部资料

图表 2021-2022财年美光科技收入分地区资料

图表 2022-2023财年美光科技综合收益表

图表 2022-2023财年美光科技分部资料

图表 2022-2023财年美光科技收入分地区资料

图表 2020-2023年杭州士兰微电子股份有限公司总资产及净资产规模

图表 2020-2023年杭州士兰微电子股份有限公司营业收入及增速

图表 2020-2023年杭州士兰微电子股份有限公司净利润及增速

图表 2022年杭州士兰微电子股份有限公司主营业务分行业、产品、地区

图表 2023年杭州士兰微电子股份有限公司主营业务分行业、产品、地区

图表 2020-2023年杭州士兰微电子股份有限公司营业利润及营业利润率

图表 2020-2023年杭州士兰微电子股份有限公司净资产收益率

图表 2020-2023年杭州士兰微电子股份有限公司短期偿债能力指标

图表 2020-2023年杭州士兰微电子股份有限公司资产负债率水平

图表 2020-2023年杭州士兰微电子股份有限公司运营能力指标

图表 2020-2021年台积电综合收益表

图表 2020-2021年台积电收入分产品资料

图表 2020-2021年台积电收入分地区资料

图表 2021-2022年台积电综合收益表

图表 2021-2022年台积电收入分产品资料

图表 2021-2022年台积电收入分地区资料

图表 2022-2023年台积电综合收益表

图表 中芯国际发展历程

图表 2020-2023年中芯国际集成电路制造有限公司总资产及净资产规模

图表 2020-2023年中芯国际集成电路制造有限公司营业收入及增速

图表 2020-2023年中芯国际集成电路制造有限公司净利润及增速

图表 2022年中芯国际集成电路制造有限公司主营业务分行业、产品、地区、销售模式

图表 2022-2023年中芯国际集成电路制造有限公司营业收入情况

图表 2020-2023年中芯国际集成电路制造有限公司营业利润及营业利润率

图表 2020-2023年中芯国际集成电路制造有限公司净资产收益率

图表 2020-2023年中芯国际集成电路制造有限公司短期偿债能力指标

图表 2020-2023年中芯国际集成电路制造有限公司资产负债率水平

图表 2020-2023年中芯国际集成电路制造有限公司运营能力指标

图表 2020-2023年华虹半导体有限公司总资产及净资产规模

图表 2020-2023年华虹半导体有限公司营业收入及增速

图表 2020-2023年华虹半导体有限公司净利润及增速

图表 2020-2022年华虹半导体有限公司营业收入情况

图表 2022-2023年华虹半导体有限公司营业收入情况

图表 2020-2023年华虹半导体有限公司营业利润及营业利润率

图表 2020-2023年华虹半导体有限公司净资产收益率

图表 2020-2023年华虹半导体有限公司短期偿债能力指标

图表 2020-2023年华虹半导体有限公司资产负债率水平

图表 2020-2023年华虹半导体有限公司运营能力指标

图表 2020-2023年江苏长电科技股份有限公司总资产及净资产规模

图表 2020-2023年江苏长电科技股份有限公司营业收入及增速

图表 2020-2023年江苏长电科技股份有限公司净利润及增速

图表 2022年江苏长电科技股份有限公司主营业务分行业、产品、地区

图表 2022-2023年江苏长电科技股份有限公司营业收入情况

图表 2020-2023年江苏长电科技股份有限公司营业利润及营业利润率

图表 2020-2023年江苏长电科技股份有限公司净资产收益率

图表 2020-2023年江苏长电科技股份有限公司短期偿债能力指标

图表 2020-2023年江苏长电科技股份有限公司资产负债率水平

图表 2020-2023年江苏长电科技股份有限公司运营能力指标

图表 2020-2023年北方华创科技集团股份有限公司总资产及净资产规模

图表 2020-2023年北方华创科技集团股份有限公司营业收入及增速

图表 2020-2023年北方华创科技集团股份有限公司净利润及增速

图表 2021-2022年北方华创科技集团股份有限公司营业收入分行业、产品、地区、销售模式

图表 2022-2023年北方华创科技集团股份有限公司营业收入分行业、产品、地区

图表 2020-2023年北方华创科技集团股份有限公司营业利润及营业利润率

图表 2020-2023年北方华创科技集团股份有限公司净资产收益率

图表 2020-2023年北方华创科技集团股份有限公司短期偿债能力指标

图表 2020-2023年北方华创科技集团股份有限公司资产负债率水平

图表 2020-2023年北方华创科技集团股份有限公司运营能力指标

图表 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司募集资金投向

图表 新一代Wi-Fi射频前端芯片研发及产业化项目具体资金投向

图表 新一代Wi-Fi射频前端芯片研发及产业化项目时间进度安排

图表 新一代Wi-Fi射频前端芯片研发及产业化项目投资进度

图表 佛山市蓝箭电子股份有限公司募集资金投向

图表 半导体封装测试扩建项目具体投资情况

图表 半导体封装测试扩建项目具体实施进度

图表 气派科技股份有限公司募集资金投向

图表 第三代半导体及硅功率器件先进封测项目投资概算

图表 第三代半导体及硅功率器件先进封测项目具体实施进度安排

图表 上海晶丰明源半导体股份有限公司募集资金投向

图表 高端电源管理芯片产业化项目投资概算

图表 高端电源管理芯片产业化项目实施进度

图表 2023年全球半导体主要并购一览（一）

图表 2023年全球半导体主要并购一览（二）

图表 中国芯片半导体行业历年投融资数量及规模

图表 中国芯片半导体行业单笔事件融资平均金额

图表 中国芯片半导体行业历年投融资事件轮次分布

图表 中国芯片半导体行业细分赛道投融资事件及规模

图表 2022年中国芯片半导体各细分领域大额融资事件（一）

图表 2022年中国芯片半导体各细分领域大额融资事件（二）

图表 中国芯片半导体行业投融资事件地区分布TOP10

图表 2022年中国芯片半导体行业活跃投资方

图表 2022年中国芯片半导体行业新晋独角兽

图表 集成电路产业投资价值四维度评估表

图表 集成电路产业市场机会整体评估表

图表 中投市场机会矩阵：集成电路产业

图表 中投顾问对集成电路产业进入时机分析

图表 中投产业生命周期：集成电路产业

图表 中投顾问投资机会箱：集成电路产业

图表 2021-2023年中国半导体产业的投资项目数量

图表 2021-2023年中国半导体产业的投资金额

图表 2021-2023年中国半导体产业项目投资均价

图表 2021-2023年重点省市半导体项目投资统计

图表 2021-2023年重点省市半导体产业投资金额来源

图表 2021-2023年重点省市半导体项目投资进出平衡表

图表 2022年A股及新三板上市公司半导体行业投资规模

图表 2023年A股及新三板上市公司半导体行业投资规模

图表 2022年A股及新三板上市公司半导体行业投资项目区域分布（按投资金额分）

图表 2022年A股及新三板上市公司半导体行业投资项目区域分布（按投资项目数量分）

图表 2023年A股及新三板上市公司半导体行业投资项目区域分布（按投资金额分）

图表 2023年A股及新三板上市公司半导体行业投资项目区域分布（按投资项目数量分）

图表 2022年A股及新三板上市公司半导体行业投资模式

图表 2023年A股及新三板上市公司半导体行业投资模式

图表 2021-2023年中国半导体企业投资金额排名TOP50

图表 2021-2023年中国半导体企业投资排名TOP100区域分布

图表 苏州锴威特半导体股份有限公司项目金额区域分布

图表 2023年苏州锴威特半导体股份有限公司半导体投资项目

图表 江苏微导纳米科技股份有限公司项目金额区域分布

图表 江苏微导纳米科技股份有限公司半导体投资项目

图表 烟台睿创微纳技术股份有限公司项目金额区域分布

图表 2019-2023年烟台睿创微纳技术股份有限公司投资项目金额

图表 2019-2023年烟台睿创微纳技术股份有限公司投资项目数量

图表 烟台睿创微纳技术股份有限公司半导体投资项目

图表 科威尔技术股份有限公司项目金额区域分布

图表 2020-2023年科威尔技术股份有限公司投资项目金额

图表 2020-2023年科威尔技术股份有限公司投资项目数量

图表 科威尔技术股份有限公司半导体投资项目

图表 江苏宏微科技股份有限公司项目金额区域分布

图表 2021-2022年江苏宏微科技股份有限公司投资项目金额

图表 2021-2022年江苏宏微科技股份有限公司投资项目数量

图表 江苏宏微科技股份有限公司半导体投资项目

图表 集成电路行业发展趋势分析

图表 中投顾问对2024-2028年中国集成电路行业销售额预测

图表 中投顾问对2024-2028年中国IC封装测试业销售额预测

图表 中投顾问对2024-2028年中国IC制造业销售额预测

公司简介

深圳市中投顾问股份有限公司于2002年在深圳成立，是中国领先的产业研究与产业战略咨询机构。十多年来，我们一直聚焦在“**产业**”领域，专注于**产业研究、产业规划、产业招商**及产业投资咨询服务。我们是国内**唯一**一家既有深厚的**产业研究**背景，又只专注于**产业投资与产业发展**服务的专业公司。对政府或园区，我们提供从产业规划到产业资源导入的一体化**产业发展咨询解决方案**；对企业，我们提供投资机会研究、投资地点选择、项目规划设计的一体化**产业投资咨询**服务。

十多年来，**深圳市中投顾问股份有限公司**已经为**十多万**家包括**政府机构、银行、研究所、行业协会、咨询公司、集团公司和各类投资公司**在内的单位提供了专业的产业研究报告、项目投资咨询及竞争情报研究服务，并得到客户的广泛认可；主导完成了上千家产业园区或地方政府的产业发展规划编制，协助数百家地方推进招商工作和产业资源导入。

深圳市中投顾问股份有限公司把实践与理论相结合，提出了“空间是躯体，产业才是灵魂”的规划理念；提炼出“建链、补链、抢链、强链”的产业发展思路；总结出落地性极强的“预招商规划法”；提炼出“战术招商上升到战略招商才是破解招商困境关键”的招商工作新思维；归纳出“规划、招商、运营三维一体”的园区发展策略；创新提出城镇化建设要“遵循产城融合，更要注意产城协调”的科学发展模式；等等。

深圳市中投顾问股份有限公司以深厚的产业研究能力为基础，以“**规划+落地**”为服务理念，以“**咨询+资源**”为服务模式，已经成为中国最专业的产业研究咨询服务机构，并力争在未来5年成为全球领先的产业投资与产业发展服务商。